Pâte à souder NP303-FLV-1B-T4 (INTERN);

GENMA EUROPE

Description du produit

Pâte à souder GENMA – notre pâte à souder éprouvée COSMO existe maintenant également sans halogène. La pâte à souder CMS NP303-COSMO-LH-T4 convainc par son mouillage exceptionnel, sa très bonne imprimabilité, sa haute définition des contours, sa longue durée de vie et sa force d'adhérence constante lors de l'assemblage. Le très bon mouillage également sur des surfaces dures assure une brasure parfaite sur les BGA. La viscosité exceptionnellement stable permet un stockage jusqu'à 12 mois, ce qui simplifie la disposition pour vous. De plus, la pâte à souder peut être transportée non refroidie. Les assemblages brasés ont peu de retassures. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après le soudage. La pâte à souder peut être soudée sous air ou sous gaz inerte.

Propriétés techniques

	Valeur spécifique	Méthode d'essai
Alliage (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Plage de fusion (°C)	217 - 221	IEC61189-11
Taille de la poudre (µm)	22 - 38, type 4	IPC-TM-650-2.2.14.2
Viscosité (Pas)	200 ± 20	IPC-TM-650-2.4.34.3
Teneur en flux (%)	11,5 ± 0,5	IPC-TM-650-2.3.34.1
Type de flux	ROL0, no clean	IPC J-STD-004B
Grille d'application (mm)	0,4	
Teneur en halogène (%)	< 0,01	IPC-TM-650-2.3.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	≤ 0,2	IPC-TM-650-2.4.35
Fonctionnement à l'impression (mm)	<0,3	IPC-TM-650-2.4.35 (150°C / 60sec)
Résistance d'isolation (Ω)	> 1 x 10^{11} (40°C 90 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Résistance d'isolation (Ω)	> 5 x 10^{8} (85°C 85 % humidité relative)	IPC-TM-650-2.6.3.3
Test de migration	Pas de migration	IPC-TM-650-2.6.14.1
Test de niveau de cuivre	Pas de corrosion	IPC-TM-650-2.3.32
Unité d'emballage	Dose (0,5 kg) cartouche Semco (0,65 kg, 1,2 kg)	
Durée de conservation minimum	12 mois à 0 - 10 °C, 3 mois < 35 °C	
Transport	Sans refroidissement	
Trempe de la pâte à souder	Amener à température ambiante à temps avant ouverture pour éviter la condensation.	
Vitesse d'impression recommandée (mm/s)	20 - 80	
Température recommandée lors de l'impression (°C)	25 ± 3	
Humidité relative recommandée en % à l'impression	50 ± 20	

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Conformité

Au 13.11.2025

Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et annexe 2015/863/EU.

Ne contient aucune substance (liste – SVHC) supérieure à la valeur limite (0,1 %) conformément au règlement REACH CE no 1907/2006.

Ne contient aucune substance conformément à la Toxic Substance Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Ne contient aucune substance conformément au règlement POP UE 2019/1021.

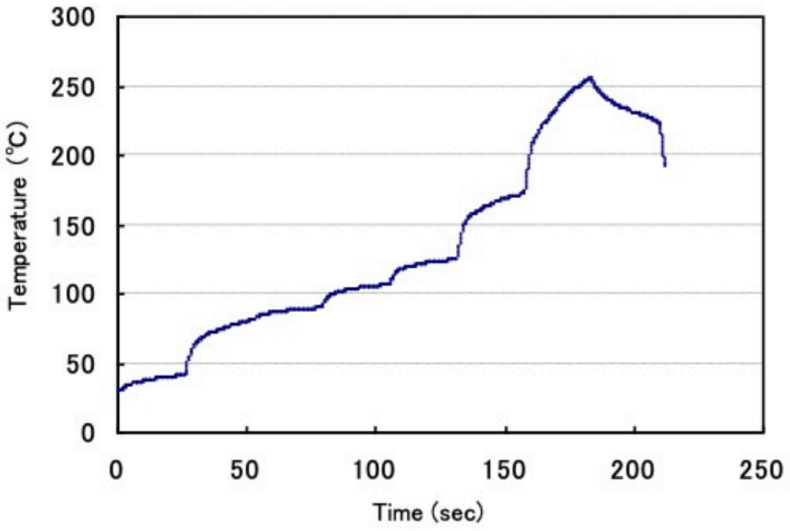
Ne contient pas de composés alkyles per- et polyfluorés (PFAS).

Ne contient pas de phtalates ni latex.

Ne contient aucune substance interdite par la Proposition 65 de Californie.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu

Profil de flux recommandé



Préchauffage

Empfohlener Restsauerstoffgehalt <500ppm in der Vorheiz- und Peakzone. Im Falle, dass einzelne Angaben nicht erfüllt werden können und daraus resultierend das Lötergebnis nicht zufriedenstellend ist, empfiehlt es sich den Restsauerstoffgehalt weiter abzusenken.

Der Temperaturanstieg bis zur Vorheizzone (100°C) sollte <2°C / Sekunde betragen. Ein zu schneller Temperaturanstieg kann zum Verlaufen der Lötpaste führen.

Um eine möglichst kleine Temperaturstreuung (⊿t) auf der Leiterplatte zu erreichen, sollte die Temperatur in der Vorheizzone 100 – 170°C und die Vorheizzeit 40 – 70 Sekunden betragen. Im Falle einer niedrigeren Temperatur und kürzerer Zeit ist die Temperaturstreuung (⊿t) auf der Leiterplatte zu groß. Bei zu hoher Temperatur und längerer Zeit gehen die Aktivatoren verloren, was dazu führen kann, dass die Lötpaste nicht aufschmilzt.

Im Bereich von 170°C bis 220°C wird ein Anstieg von 4°C empfohlen. Im Falle eines langsameren Temperaturanstieges kann der Aktivator im Flussmittel verloren gehen, was dazu führt, dass die Lötpaste nicht schmilzt.

Pic de reflux

Wir empfehlen, die Temperatur möglichst 30 – 90 Sekunden über 220°C zu halten. In der Spitze sollten Temperaturen von 250 - 270°C erreicht werden. Dabei sollte sichergestellt sein, dass die Bauteile für die hohe Temperatur geeignet sind. Empfohlenes Vakuum <10kPA. Eine zu niedrige Temperatur und/oder ein zu schwaches Vakuum können dazu führen, dass Voids und/oder Rückstände vom Flussmittel auf der Lötstelle verbleiben.

Refroidissement

Die Abkühlgeschwindigkeit sollte <10°C / Sekunde betragen. Zu langsames Abkühlen kann dazu führen, dass sich Bauteile verschieben oder aufstellen und die Stärke der Lötverbindungen schwächen. Zu schnelles Abkühlen dagegen kann Bauteile durch thermischen Schock beschädigen.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu